



1. *Размеры для справок*
2. *Покрытие платы HASL.*
3. *Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.*
4. *Элементы поз.49,57,59,63 устанавливать до упора в плату.*
5. *Элементы поз.31 устанавливать на прокладку выполненную из отрезка лены от чип-элементов.*
6. *На место поз.61 запаять шлейф IDC-20 (шаг 2,54мм) длиной 10см*
7. *Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.*
8. *Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015*

					<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;"> BOOM-MCU_01v1 СБ </div>				
0					<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;"> Плата BOOM-MCU_01v1 </div> <div style="text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold;"> Сборочный чертеж </div>				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.	Щедлыкин М.В			16.09.15					
Проб.									
Т.контр.									
					Литера		Масса	Масштаб	
								1:1	
					Лист		Листов 1		
Н.контр.									
Утв.									